



软包动力电池加速渗透， 关注产业链优质企业

强于大市

行业指数相对表现



资料来源：贝格数据（截至 2018 年 08 月 03 日）

指数名称	周涨跌幅	年涨跌幅
电子	-8.80%	-26.87%
上证综指	-4.63%	-17.14%
深证成指	-7.46%	-22.09%
沪深 300	-5.85%	-17.75%
中小板指	-8.14%	-21.35%
创业板指	-7.08%	-15.46%

资料来源：Wind（截至 2018 年 08 月 03 日）

分析师

杨文为

执业证书编号：S1330517030001

电话：028-86199307

邮箱：yangww@hxzb.cn

◇ 本周行业观点：

软包动力电池加速渗透，关注产业链优质企业。我国新能源汽车在政策鼓励、成本降低等因素的带动下快速发展，同时，补贴政策的变化与技术的进步也使得动力电池呈现出向高能量密度方向发展的趋势。软包动力电池相比方形与圆柱动力电池更能满足高能量密度设计需求，预计其渗透率将不断提升，在消费电子应用趋缓的情况下带动软包电池产业链快速增长，建议关注产业链中技术成熟的优质企业。主要观点如下：1) **政策鼓励、成本降低等因素助力新能源汽车快速发展。**过去几年，我国新能源汽车在政策鼓励、成本降低等因素的带动下快速发展，中汽协数据显示，我国新能源汽车销量从 2014 年的 7.5 万辆增加到 2017 年的 77.7 万辆，年复合增速为 118.23%，盖世汽车研究院预计 2020 年我国新能源汽车销量将进一步提高到 245 万辆。中长期来看，双积分政策在以前补贴政策的基础上，通过对乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分同时考核，成为未来新能源汽车加速渗透的重要支撑，成本降低、消费者接受度提高等因素也将助力新能源汽车快速发展。2) **动力电池能量密度提升趋势下，软包动力电池将加速渗透。**财政部等四部门发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》通过提高补贴门槛、细化补贴标准等方式鼓励高能量密度、高续航里程车型的应用。软包动力电池具有质量轻、安全稳定等优势，更能满足能量密度设计需求，技术的进步也成为软包动力电池加速渗透的重要因素，今年部分厂商三元软包单体比能量 260wh/kg 的电芯产品已经达到量产水平。根据高工产研锂电研究所 (GGII) 数据显示，2018 年第一季度我国软包动力电池出货量占比为 13.95%，而今年在建的产能及规划情况中，软包电池产能占比已上升至 29%。我们预计在补贴新政、技术进步等因素的影响下，软包动力电池将加速渗透。3) **软包动力电池加速渗透，关注产业链优质企业。**软包动力电池渗透率的提高将带动软包电池的市场需求快速增长，据 OFweek 产业研究院测算，2017-2022 年我国软包电池的需求量将从 26Gwh 增长至 94GWh，年复合增长率为 29.31%。铝塑膜作为软包电池关键包装材料，在软包电池加速渗透的趋势下也将迎来需求增长期。我们预计，新能源汽车快速发展、软包动力电池渗透率提高等多重因素将带动软包电池需求，建议关注产业链中技术成熟的优质企业：**新纶科技、亿纬锂能。**

◇ 上周市场回顾：

上周电子（申万）涨幅为-8.80%，跑输沪深 300 指数（-5.85%），跑输创业板指数（-7.08%），涨跌幅在各行业中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为贤丰控股、环旭电子、京泉华、锦富技术、春兴精工，跌幅前五的个股为金龙机电、大华股份、坚瑞沃能、电连技术、拓邦股份。

◇ 行业新闻动态：

基金密集设立，投资机构加速布局芯片产业；韩国将投资 13.4 亿美元以强化半导体实力；中国将加快集成电路、5G 关键元器件等领域标准研制；IDC：华为超过苹果，成为全球第二大手机制造商。

◇ 行业公司重点公告：

英唐智控：对外投资设立控股子公司；**东晶电子：**实际控制人发生变更；**正业科技：**终止非公开发行 A 股股票。

◇ **风险提示：**市场竞争加剧，新能源汽车渗透不及预期，国家政策变化。

本周行业观点

软包动力电池加速渗透,关注产业链优质企业。我国新能源汽车在政策鼓励、成本降低等因素的带动下快速发展,同时,补贴政策的变化与技术的进步也使得动力电池呈现出向高能量密度方向发展的趋势。软包动力电池相比方形与圆柱动力电池更能满足高能量密度设计需求,预计其渗透率将不断提升,在消费电子应用趋缓的情况下带动软包电池产业链快速增长,建议关注产业链中技术成熟的优质企业。主要观点如下:

1) 政策鼓励、成本降低等因素助力新能源汽车快速发展。过去几年,我国新能源汽车在政策鼓励、成本降低等因素的带动下快速发展,中汽协数据显示,我国新能源汽车销量从 2014 年的 7.5 万辆增加到 2017 年的 77.7 万辆,年复合增速为 118.23%,盖世汽车研究院预计 2020 年我国新能源汽车销量将进一步提高到 245 万辆。中长期来看,双积分政策在以前补贴政策的基础上,通过对乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分同时考核,成为未来新能源汽车加速渗透的重要支撑,成本降低、消费者接受度提高等因素也将助力新能源汽车快速发展。

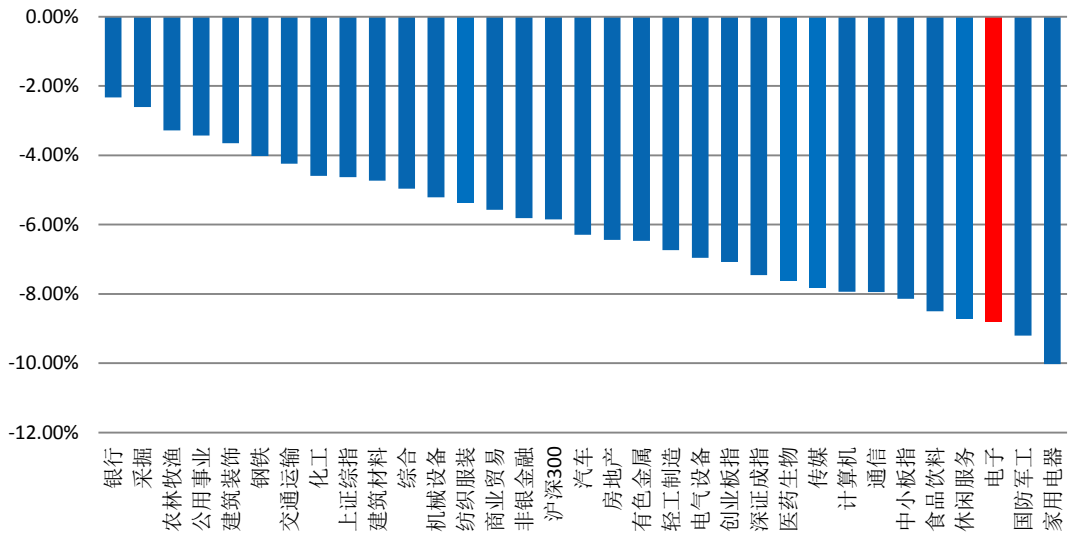
2) 动力电池能量密度提升趋势下,软包动力电池将加速渗透。财政部等四部门发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》通过提高补贴门槛、细化补贴标准等方式鼓励高能量密度、高续航车型的应用。软包动力电池具有质量轻、安全稳定等优势,更能满足能量密度设计需求,技术的进步也成为软包动力电池加速渗透的重要因素,今年部分厂商三元软包单体比能量 260wh/kg 的电芯产品已经达到量产水平。根据高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2018 年第一季度我国软包动力电池出货量占比为 13.95%,而今年在建的产能及规划情况中,软包电池产能占比已上升至 29%。我们预计在补贴新政、技术进步等因素的影响下,软包动力电池将加速渗透。

3) 软包动力电池加速渗透,关注产业链优质企业。软包动力电池渗透率的提高将带动软包电池的市场需求快速增长,据 OFweek 产业研究院测算,2017-2022 年我国软包电池的需求量将从 26Gwh 增长至 94GWh,年复合增长率为 29.31%。铝塑膜作为软包电池关键包装材料,在软包电池加速渗透的趋势下也将迎来需求增长期。我们预计,新能源汽车快速发展、软包动力电池渗透率提高等多重因素将带动软包电池需求,建议关注产业链中技术成熟的优质企业:**新纶科技、亿纬锂能。**

上周市场回顾

行业涨跌幅

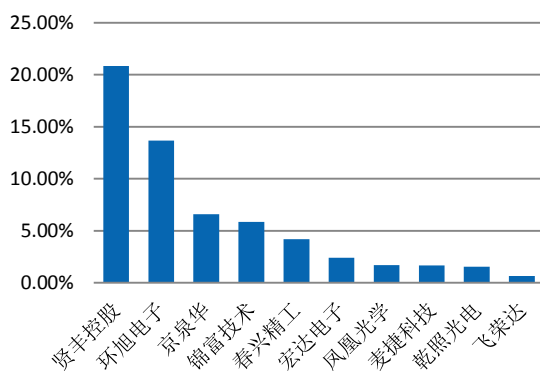
上周电子(申万)涨幅为-8.80%,跑输沪深 300 指数(-5.85%),跑输创业板指数(-7.08%),涨跌幅在各行业中排名靠后。

图表 1：上周电子行业与各行业（申万）及主要指数涨跌幅比较


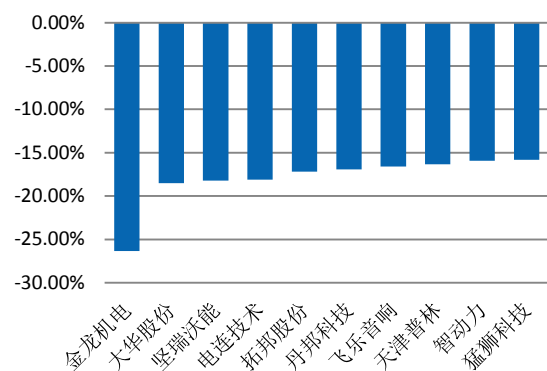
资料来源：Wind、宏信证券研究发展部

行业个股涨跌幅

上周行业内涨幅前五的个股为贤丰控股（20.85%）、环旭电子（13.68%）、京泉华（6.58%）、锦富技术（5.84%）、春兴精工（4.18%），跌幅前五的个股为金龙机电（-26.33%）、大华股份（-18.50%）、坚瑞沃能（-18.22%）、电连技术（-18.09%）、拓邦股份（-17.17%）。

图表 2：上周行业涨幅前十公司


资料来源：Wind、宏信证券研究发展部

图表 3：上周行业涨幅后十公司


资料来源：Wind、宏信证券研究发展部

行业新闻动态

基金密集设立，投资机构加速布局芯片产业

赛近期，芯片企业发展和芯片产业投资成为热门话题。一级市场，专门投资芯片（集成电路）的基金纷纷设立，还涌现了一些深耕芯片产业的投资机构。

芯片产业发展迎来新动力

中基协数据显示,今年4月以来,在基金业协会备案的带有“芯片”、“集成电路”、“半导体”字样的私募股权、创业投资基金共有14只,约占全部51只基金的27.45%。也就是说,这三个多月备案的与芯片相关的一级市场基金,占到2014年开始备案以来的近三成。近日,南京市也明确将建立总规模200亿美元的集成电路产业投资基金。

不只是基金,中基协数据还显示,4月以来,共有3家专门投资芯片相关产业的基金管理人进行了登记备案,分别为安徽集成电路产业投资管理有限公司、上海集成电路产业投资管理有限公司和上海半导体装备材料产业投资管理有限公司。

此外,2014年9月成立的国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)今年5月也向国务院上报了二期方案并已获批,且近期也开始有了投资新动作。光大证券研报显示,大基金二期预计规模在1500亿元-2000亿元,按照1:3的撬动比,所撬动的社会资金规模在4500亿元-6000亿元左右。

专注集成电路产业投资的浑璞投资,近一年先后发行并备案了5只相关基金。其合伙人姜寅明在接受记者采访时分析了在众多行业中选择集成电路产业的逻辑。“从产业角度看,集成电路产业目前在中国发展趋势向好:下游需求旺盛且持续增长,产业加速向内转移,国产化水平低但各细分领域正全面追赶,政策上支持力度很大。”

此外姜寅明认为,从投资标的看,集成电路产业市场规模大、细分领域多,且各细分领域市场容量都足够大,利于投资布局;从竞争角度看,集成电路产业专业门槛高、技术变化快、学习成本高,需要长期持续投入,投资周期长,这样的“苦活累活”很多人不愿意干,但也意味着行业竞争相对不那么激烈。

芯片产业投资机遇

的确,芯片投资常常被认为是“苦活累活”。业内人士普遍认为,芯片投资的难点在于:一方面企业前期投入大,周期长,成本高;另一方面芯片利润回报处于平均水平,企业估值往往不够高。因此对机构来说,投入回报比不如投资互联网企业那么高。

花旗集团风险分析部总监杨立功估计,大概五年时间中国会在某些领域突破芯片上的封锁,而这其中最大的推动力是来自资本方,还有国家产业基金,是双方合力的结果。

姜寅明表示,全国上下达成战略共识,必须加快集成电路产业国产化,这相应带来了人才、资金等方面的利好。而十亿人口级别的巨大市场是集成电路产业加速向中国转移的最大动力,也是集成电路产业最终将成功国产化的决定因素。现阶段集成电路技术迭代放缓,也给中国企业追赶先进技术带来了难得的时间窗口和机遇。

英诺基金、臻云创投的合伙人祝晓成接受记者采访时表示,芯片行业需要大资金、长时间、政府支持和产业协作,未来的发展任重道远。目前在人工智能的迅猛发展下,AI芯片也很受关注。“我们在投资芯片项目时除了考量未来市场空

间、团队的差异化技术能力和丰富的行业背景外,也很关注项目落地的应用场景和时间。”

http://press.chnfund.com/paper/zgjib/html/2018-07/30/content_1187230.htm

韩国将投资 13.4 亿美元以强化半导体实力

韩国工业部长白云揆 (Paik Un-gyu) 于 30 日)参访了三星 和 SK 海力士的主要半导体生产线,并誓言将在未来 10 年内投资 1.5 兆韩元 (13.4 亿美元)来强化韩国半导体的竞争力。

“为了让韩国持续作为世界顶级半导体巨头国,我们将以三个战略为中心支持芯片产业的发展,”白云揆于参访时表示。

芯片市场是韩国工业的重要支柱,作为亚洲第四大经济体,半导体芯片约占韩国出口的 20%。

三星是全球最大的存储器芯片制造商,在 DRAM 和 NAND 方面排名第一,而 SK 海力士则在 DRAM 和 NAND 分别排名亚军和第五名。白云揆表示,韩国的制造商在 DRAM 和 NAND 行业拥有超强的竞争力,但已达到极限,需要开发新的材料和设备。

韩国工业部表示,将与科学和信息通信技术部门合作,对韩国半导体产业进行必要的投资。政府投资的 13.4 亿美元将用于开发新的半导体材料和器件,全力促使该国成为全球半导体枢纽。三项重点将是开发存储器芯片、协调 IC 设计厂与晶圆厂的互利共生,并吸引全球半导体材料和设备制造商在韩国建立生产中心。

近期中国的“中国制造 2025”计划的首要任务就是要发展半导体技术,且中国政府已经在半导体产业投入数十亿美元。此举引发了韩国的担忧。此外,中国企业也积极在韩国寻找人才以获取技术知识。

“公司的大规模投资是振兴国民经济和创造就业机会的最佳方式。”白云揆部长回应 SK 海力士在首尔东南部利川市建立新生产线计划时表示。SK 海力士日前表示,预计到 2020 年将投资 3.5 兆韩元设厂。

http://www.semi.org.cn/news/news_show.aspx?ID=53542&classid=117

中国将加快集成电路、5G 关键元器件等领域标准研制

记者近日从中国电子技术标准化研究院获悉,中国将加快集成电路、新型显示技术、虚拟/增强现实、智慧健康养老、5G 关键元器件等重点标准和基础公益标准研制。

当日在苏州举行的“2018 新一代信息技术产业标准化论坛”上,中国电子信息行业联合会会长王旭东表示,在标准化领域,中国一大批自主产业科技成果向共性技术标准的成功转化,推动着产业规范有序快速发展,促进产业升级;同时,借着“一带一路”东风,新一代信息技术重点领域标准不断与国际接轨,自主技术国际标准转化率显著提升。

工信部电子信息司副司长吴胜武说,2018年将加快集成电路、新型显示技术、虚拟/增强现实、智慧健康养老、5G 关键元器件等重点标准和基础公益标准研制,积极开展智能传感器、智能硬件等新兴领域综合标准化体系建设,积极参与国际标准化工作,以国际标准提案为核心,推动更多国内标准成为国际标准。

中国国家标准化管理委员会工业标准二部副主任王莉建议,统筹国际国内,提升国际标准的参与度和话语权,积极鼓励和组织国内新一代信息技术领域的专家、龙头企业积极参与国际标准化工作,加强国际交流,积累国际标准化经验,选取重点领域,推动将创新成果融入国际标准,为国际标准化做出中国专家的贡献。

中国电子技术标准化研究院院长赵波说,该院聚焦制造强国和网络强国战略全局,在两化融合、军民融合、智能制造、绿色制造以及重要关键元器件、安全可靠软硬件、云计算、大数据、物联网、人工智能、网络安全、新兴信息产品等领域的标准化工作取得了成绩。

本次论坛设立了人工智能、智能制造、数据安全、无人机应用等十二个热点技术专题分论坛,为促进新一代信息技术标准化及产业进步提供了交流平台。

http://www.semi.org.cn/news/news_show.aspx?ID=53538&classid=117

IDC：华为超过苹果，成为全球第二大手机制造商

市场调研公司 IDC 于 7 月 31 日发布的报告显示,今年第二季度全球智能手机出货总量达到 3.42 亿部,较去年同期的 3.482 亿部下滑 1.8%。其中,华为当季智能手机出货总量达到 5420 万部,同比增长 40.9%,超越苹果成为全球第二大智能手机制造商。小米当季智能手机出货总量达到 3190 万部,同比增长 48.8%,销量排名仅次于苹果。

报告显示,苹果二季度市场份额从去年同期的 12.1%降至 11.8%,被中国华为科技有限公司超越。

华为的市场份额从去年同期的 11%增至 15.8%,成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。

三星电子二季度市场份额也出现萎缩,从去年同期的 22.9%降至 20.9%。

IDC 负责全球手机追踪调查项目的副总裁 Ryan Reith 表示:“至少可以说,华为的持续增长令人印象深刻。直到最近,该品牌在市场上的知名度还很低。”

IDC 全球移动设备追踪项目副总裁赖安·雷斯(Ryan Reith)表示:“华为的持续增长令人印象深刻,其市场渗透能力同样惊人。在不久之前,该品牌还基本上不为人知。值得注意的是,在新品发布后的两个季度,苹果的排名都有所上升,因此我们很可能在 2018 年及以后看到排名靠前的公司位置继续上升。”

二季度,华为在中国智能手机市场继续保持领先地位,市场份额达到 27%,创历史新高。在本季度上半期,华为的 P20/P20 Pro 系列产品在 600- 800 美元的价格区间需求强劲,这帮助华为在市场上树立了非常好的形象。下半期,随着“GPU Turbo”技术的发布,华为继续赢得了良好的声誉。“618”促销活动

促使荣耀机型在网络渠道的销售强劲,荣耀品牌是这家科技巨头增长的关键驱动力。

http://www.cnii.com.cn/digital/2018-08/02/content_2088781.htm

英飞凌与阿里云签署物联网合作备忘录

2018年8月2日,英飞凌科技与阿里云计算有限公司(以下简称“阿里云”)签署合作备忘录,共同推进物联网技术在智慧生活、工业等领域的应用,助力中国企业的数字化转型升级。

作为工业 4.0 的积极推动者和实践者,英飞凌将凭借自身在物联网领域的核心技术和服务优势,与阿里云的物联网操作系统 AliOS Things 开展全面合作和技术服务。与此同时,随着物联网应用进程的加速,对系统安全也提出了新的要求。此次合作中,双方将进一步探讨物联网的规划、实施方案及安全标准,使中小企业和个人能以一种低成本、高可靠的方式部署和接入阿里云服务。让参与方在共享物联网发展红利的同时,也能免受安全隐患所带来的损失。并且,双方约定将在电商渠道方面逐步开展全面合作。

以此为基础,双方将借助阿里云在物联网领域的整合能力和成功经验,共同打造先进、安全的物联网解决方案,助力中小企业智能数字化转型升级,用数字化手段统筹管理生产全流程。

阿里巴巴副总裁、阿里云 IoT 事业部总经理库伟先生表示:“物联网生态系统的建设与完善需要集结各方优势资源与力量。此次合作将阿里云在操作系统等方面的能力与英飞凌的半导体技术优势相结合,相信这将有力地推进物联网在智慧工业等领域的落地。”

英飞凌电源管理及多元化市场事业部总裁 Andreas Urschitz 先生也表示:“作为全球领先的半导体厂商,英飞凌一直致力于将我们先进的物联网半导体解决方案与当地经验相结合。我们深信,此次和阿里云的合作将成为我们在这一领域努力的典范。”

英飞凌电源管理及多元化市场事业部大中华区副总裁潘大伟先生也表示:“可持续发展是英飞凌最为重要的发展战略之一,也是我们在中国市场的长期目标。我们很高兴能够与阿里云这样的领先企业携手合作,共同打造能够满足本地市场需求的物联网服务平台,助力企业数字化转型,并为中国智慧城市创新与发展提供动力引擎。”

<http://www.cena.com.cn/semidesign/20180803/94975.html>

2018 年上半年电子信息业平稳增长,新兴领域创新升温

2018 年上半年,在复杂多变的全球经济贸易和持续推进的国内供给侧结构性改革形势下,我国电子信息产业在波动中维持平稳增长,新兴领域创新发展持续升温,骨干企业资本化和创新发展步伐加快。但同时,随着中美政治经济关系进入质变期,逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向加强,全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇。在产业发展内外部环境多变化的形势下,应加快构建电子信息产业供应链安全体系,攻坚电子信息领域基础核心技术,打开“抱团出

海”的产业国际竞争新局面，发挥产学研用协同创新势能，塑造产业竞争优势和发展新路径。

产业在波动中平稳增长，新兴领域创新发展持续升温

今年上半年，我国电子信息产业的总体形势表现在四个方面。

第一，产业在波动中维持平稳增长。

从宏观层面来看，GDP 三驾马车全部呈现下行趋势。投资增速趋势性下行，1—5 月固定资产投资增速 6.1%，创自 1999 年 12 月以来新低。基础设施建设投资从 2017 年 11 月的 20.1% 跌到 2018 年 5 月的 9.4%，呈现快速下行趋势。贸易顺差已从近两年月均 400 亿美元减少到月均 200 亿美元左右。消费增速仅为 8.5%，创自 2003 年 5 月以来新低。从行业层面来看，三项主要数据稳中存忧。产业增加值增速、收入、利润等数据保持持续增长，但增速普遍下降。

增加值平稳增长，增速小幅下降。工信部运行监测协调局数据显示，1—5 月电子信息制造业增加值同比增长 12.8%，低于去年同期 0.9 个百分点。据 2017 年以来分月增速数据，2018 年 1—4 月产业增加值增速较去年同期均有下降。

收入延续增长态势，利润总额大幅下降。1—5 月，全行业主营业务收入同比增长 8.9%，低于去年同期 5.1 个百分点。与此同时，行业成本增速高达 9.7%，导致利润总额增速大幅下降，1—4 月同比降幅达 5.3%。5 月利润总额虽有所回升，累计增速达 4.3%，但仍低于去年同期 10.6 个百分点。

投资增幅呈现下滑，细分领域仍有增势。今年 1—5 月，全行业固定资产投资同比增长 14.6%，较 2017 年降低 14.4 个百分点。受人工智能、汽车电子、5G 等新兴领域应用的带动，以及“中兴事件”发生后政府和行业巨头加速布局，通信设备制造业、集成电路制造业、半导体分立器件制造业投资景气度突出，同比增速分别为 30.5%、28.1% 和 33.1%。

第二，产业出口保持增长，增速放缓明显。

1—5 月，电子信息制造业出口交货值同比增长 7.4%，较去年同期回落 5.1 个百分点。上半年出口增速放缓与去年同期出口增速的高基数有关。除通信设备外，主要行业出口增速均呈现不同程度的回落。其中，1—4 月计算机、电子元件、电子器件制造行业出口交货值同比增速分别为 5.2%、10.2%、2.5%，较去年同期分别回落 5.2 个、2.2 个、12 个百分点。值得注意的是，受中美贸易摩擦导致的厂家应激性出口备货拉动影响，1—5 月彩电出口交货值同比增速高达 26.6%。

第三，新兴领域创新发展持续升温。

各大厂商积极前瞻性布局 5G、人工智能、汽车电子、超高清视频、VR/AR 等新兴领域。5G 领域，华为等手机企业高度重视 5G 研发布局。2018 年 2 月，华为推出全球首款基于 3GPP 标准的商用 5G 芯片“Balong 5G01”，支持全球主流 5G 频谱，4 月 5G NR 产品获全球首张“欧盟通行证”，并预计在 2019 年下半年推出支持 5G 网络频段的手机。OPPO、小米、联想、vivo 等诸多智能手机厂商均成为高通“5G 领航计划”合作伙伴。人工智能领域，根据市场研究和

咨询公司 Compass Intelligence 发布的 2018 年度全球 AI 芯片公司排行榜,我国海思、寒武纪等 7 家企业入围 Top 24 榜单,在 AI 芯片领域进步明显。虚拟现实领域,行业巨头积极推动 VR/AR 技术商用化进程。腾讯与人民教育出版社签署战略合作协议,共同推动 AR 教材等新技术、新产品及其在教育领域的融合创新应用。

第四,骨干企业资本化和创新发展步伐加快。

浪潮、曙光、京东等部分龙头企业第一季度营收增速显著,骨干企业投融资步伐加速。小米已经于 5 月 3 日向港交所递交了上市申请,并于 6 月 7 日通过了上市聆讯。5 月 31 日,商汤科技宣布完成 C+轮 6.2 亿美元融资,目前估值超过 45 亿美元,继续保持全球总融资额最大、估值最高的人工智能独角兽地位。企业不断推进应用领域创新。例如,6 月 18 日京东配送机器人正式上路,第一驾超重型无人机正式下线(有效载重量达到 40 吨~60 吨,飞行距离超过 6000 公里),还打造了无人智慧配送站、无人仓等配套系统,形成了对传统物流模式的极大颠覆。企业持续引领新兴领域产品创新。展锐发布首款支持人工智能应用的 8 核 LTE SoC 芯片平台。百度发布国内首款云端全功能 AI 芯片“昆仑”,可在功耗 100W 情况下提供 260Tops 的运算能力,是迄今为止业内设计算力最高的 AI 芯片。

产业安全意识欠缺,核心技术持续性投入不足

我国电子信息产业长期以来处于“大而不强”的局面,特别是在今年以来中美贸易摩擦加剧和常态化的新外部形势下,集中表现为四大问题。

一是供应链视角的产业安全意识欠缺。“中兴事件”的棘手和被动体现了美国对我国电子信息产业进行的精准打击,反映了我国仍缺乏对电子信息产业供应链中芯片、操作系统、材料、设备等部分核心环节的掌控力,存在以点及面、一击即溃的产业安全威胁。

二是核心技术路线方向不明和持续性投入不足。在芯片计算架构、手机操作系统等存在不同路线的基础核心领域,长期以来的资金和项目支持存在分散、量小、不持续等问题,偏离了当前电子信息领域核心技术全球竞争的强投入、高风险、系统化竞争的趋势,难以助力我国实现从后发追赶到引领发展。

三是产业全球化的发展逻辑差异。自今年上半年以来,针对电子信息产业领域的知识产权保护、专利授权摩擦、反垄断调查等国际案件频发,在中美贸易摩擦全面加剧的背景下,单个企业的单打独斗更加难以抵挡国家和地区主管部门和龙头企业的施压,往往落得不利结局,体现了我国电子信息产业缺乏对专利保护和反垄断等全球法律政策框架的系统认识和集体应对。

四是产学研用未发挥联合效应。与美国等电子信息强国相比,我国电子信息产业的发展侧重于应用领域创新,未将市场规模和优势与基础研发领域相结合,我国在电子信息领域的原始创新与应用创新呈现“两张皮”,底层基础核心技术研发能力和储备远远低于新产品和新服务的市场开拓能力。

构建供应链安全体系,攻坚基础核心技术

针对目前我国电子信息产业发展存在的问题,提出以下四点建议。

一是构建电子信息产业供应链安全体系。深入开展产业供应链研究分析,梳理电子信息产业供应链共性短板和缺环,对重点领域和产品的供应链进行细致分解。鼓励电子信息产业集群重点区域和行业协会启动供应链“补链建链”计划,抓重点、分批次地建立自主可控的我国电子信息产业全供应链。

二是攻坚电子信息领域基础核心技术。要下定决心、保持恒心、找准重心,加速推动信息领域核心技术突破。瞄准集成电路先进制造工艺、芯片设计、桌面/移动操作系统、基础行业软件等基础核心技术领域,编制核心技术发展路线图,有的放矢,针对棘手的技术短板开展联合攻关,建立研发成果共享机制。

三是打开“抱团出海”的产业国际竞争新局面。强化知识产权意识,加速国内关键技术领域的专利标准部署,加速海外专利部署。增强行业主管部门的统筹协调,推动行业协会等组织的市场化和专业化,强化海外市场环境和专利风险分析,带领企业“抱团出海”,形成有组织、有议价能力的行业国际化势头。

四是发挥产学研用协同创新新势能。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,加强企业、行业协会、学界等跨界交流合作,推进技术创新、业态创新、商业模式创新等多元创新发展。发挥高校和研究院所在高端芯片、操作系统、5G等基础领域的研发技术,加强与产业和市场的对接,加快研发具有强大用户基础和全球竞争力的关键核心产品。

<http://www.cena.com.cn/industrynews/20180801/94929.html>

行业公司重点公告

英唐智控：对外投资设立控股子公司

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与深圳市太平洋自动化设备有限公司(下称“深圳太平洋”或“乙方”)共同出资设立惠州市英唐光电科技有限公司(下称“英唐光电”或“标的公司”,实际名称以工商登记为准),其中公司出资7,500万元,深圳太平洋出资2,500万元。工商登记完成后,公司将持有英唐光电75%的股权,成为英唐光电的控股股东。

为完善公司现有的供应链条,加快实现公司智能消费电子元器件产业链“一站式”服务的发展战略,公司拟开发和布局具有技术前瞻性的3D曲面玻璃等新产品。本次投资项目建设通过购置先进的生产设备和检测设备,新建3D曲面玻璃生产线,满足客户对智能手机外观创新等行业发展的需求,提升公司盈利能力,是落实公司既定发展战略目标的重要举措。

东晶电子：实际控制人发生变更

浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)实际控制人苏思通先生与上海创锐投资管理有限公司(以下简称“创锐投资”)、上海鹰虹投资管理有限公司(以下简称“鹰虹投资”)于2018年4月18日签署《财产份额转让协议》,约定苏思通先生将其实际持有的宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)(以下简称“蓝海投控”)52,798.8737万元有限合伙财产份额分别向创锐投资及鹰虹投资转让,其中将35,661.9124万元财产份额(占蓝海投控出资比例为67.53%)转让给创锐投资、将17,136.9613万元财

产份额(占蓝海投控出资比例为 32.45%)转让给鹰虹投资;同时苏思通先生与创锐投资签署《股权转让协议》,约定苏思通先生将其持有的宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司(以下简称“思通卓志”)51.00%的股权以 0 元价格转让给创锐投资(以下合称“本次权益变动”)。

本次权益变动完成后,创锐投资将成为蓝海投控执行事务合伙人思通卓志的控股股东,创锐投资通过取得思通卓志 51.00%股权以及取得蓝海投控 67.53%有限合伙财产份额,从而间接取得蓝海投控所持有的公司 25.10%股票表决权(含登记在蓝海投控名下之 10.02%公司股票以及未登记在蓝海投控名下但其通过接受委托行使表决权之 15.08%公司股票),公司控股股东仍然为蓝海投控,实际控制人将变更为钱建蓉先生。

正业科技：终止非公开发行 A 股股票

广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 31 日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》,鉴于目前的资本市场融资环境发生了较大的变化,公司认为继续推进本次非公开发行 A 股股票工作已不符合资本市场实况,不符合公司实际情况,经公司审慎决策,决定终止本次非公开发行事宜。

目前公司经营正常,终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及股东的利益。公司将继续以自有资金及其他融资方式筹集资金,推进智能装备制造中心项目、FPC 用功能性膜材料扩产及技术改造项目、总部大楼建设项目、研发中心建设项目的建设,以支持和确保公司业务的快速发展。

纳思达：控股股东拟非公开发行 2018 年可交换公司债券

纳思达股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司(以下简称“赛纳科技”)的通知,获悉赛纳科技拟非公开发行 2018 年可交换公司债券(以下简称“本次可交换债券”),赛纳科技拟将其所持本公司部分股票及其孳息(包括送股、转股和现金红利)为标的,面向合格投资者非公开发行总额不超过 30 亿元人民币的可交换公司债券。2018 年 8 月 1 日,赛纳科技取得深圳证券交易所出具的《关于珠海赛纳打印科技股份有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2018]437 号),赛纳科技面向合格投资者非公开发行本次可交换债券符合深圳证券交易所的转让条件,深圳证券交易所对本次转让无异议。

截至本公告披露日,赛纳科技共持有本公司股份 660,398,910 股,占公司总股本的 62.09%,为公司控股股东;其持有的本公司股份累计被质押 302,485,648 股,占总股本的 28.44%。

苏州恒久：持股 5%以上股东减持股份

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“苏州恒久”或“公司”)于 2018 年 8 月 3 日收到持股 5%以上股东苏高新风投出具的《关于所持苏州恒久光电科技股份有限公司股份的减持计划告知函》,持本公司股份 10,145,679 股(占本公司总股本比例 5.28%)的股东江苏省苏高新风险投资股份有限公司(以下简

称“苏高新风投”)计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,920,000 股,占本公司总股本的 1%;自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,840,000 股,占本公司总股本的 2%。

风险提示

市场竞争加剧,新能源汽车渗透不及预期,国家政策变化。

公司评级说明：

买入 (Buy) : 预期未来 6 个月内, 股价表现强于沪深 300 指数 20%以上。

持有 (Hold) : 预期未来 6 个月内, 股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于+5% ~ +20%。

中性 (Neutral) : 预期未来 6 个月内, 股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出 (Sell) : 预期未来 6 个月内, 股价表现弱于沪深 300 指数 5%以上。

行业评级说明：

强于大市：预期未来 6 个月内, 行业指数涨幅强于沪深 300 指数 10%以上。

跟随大市：预期未来 6 个月内, 行业指数涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%~+10%。

弱于大市：预期未来 6 个月内, 行业指数涨幅弱于沪深 300 指数 10%以上。

分析师声明：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责, 保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据, 特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明：

宏信证券有限责任公司 (以下简称“本公司”) 经中国证券监督管理委员会核准, 取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告, 是证券投资咨询业务的一种基本形式, 本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析, 形成证券估值、投资评级等投资分析意见, 制作证券研究报告, 并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供本公司客户使用。报告中的信息来源于已公开的资料, 本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议, 本公司及与本公司有关联的任何个人, 均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告的版权为我公司所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。